# 2026-2031年挠性覆铜板FCCL行业现状分析及投资价值研究报告

## 报告简介

在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近百万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了!企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢地锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求及前景。

随着挠性覆铜板FCCL行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的挠性覆铜板FCCL企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中道泰和利用多种独创的信息处理技术，对挠性覆铜板FCCL行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告由中道泰和的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、51行业报告网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个挠性覆铜板FCCL行业的市场走向和发展趋势。

本报告专业!权威!报告根据挠性覆铜板FCCL行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国挠性覆铜板FCCL行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国挠性覆铜板FCCL行业将面临的机遇与挑战，对挠性覆铜板FCCL行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是挠性覆铜板FCCL企业、学术

科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值!

**报告目录**

**第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求 17**

第一节 按不同基材分类的fccl品种 17

第二节 按不同构成分类的fccl品种 17

第三节 按不同应用领域分类的fccl品种 17

第四节 fccl品种的其它分类 17

第五节 产品主要采用的标准及性能要求 18

一、fccl管理体制 18

二、fccl相关标准 18

三、fccl的主要性能要求 20

**第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究 23**

第一节 三层型fccl的制造工艺法及其特点 23

一、片状制造法 23

二、卷状制造法 23

第二节 二层型fccl的制造工艺法及其特点 24

一、涂布法 24

二、溅射 电镀法 25

三、层压法 26

四、三种工艺法生产的2l-fccl在性能、工艺特点方面的比较 27

第三节 近年fpc的技术发展方面 28

一、二层型fccl已成品种发展的主流 28

二、fccl近年在技术方面的进步 29

**第三章 2021-2026年世界挠性覆铜板市场现状分析 30**

第一节 2021-2026年世界挠性覆铜板产业发展概述 30

一、世界挠性覆铜板产业发展概述 30

二、世界fccl市场规模及结构 31

三、世界挠性覆铜板价格竞争分析 31

四、fccl原材料形态结构发生变化 32

第二节 2021-2026年世界挠性覆铜板区域市场分析 33

一、美国 33

二、日本 35

三、欧洲 36

四、韩国 37

五、中国台湾 38

第三节 2026-2031年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析 39

**第四章 2021-2026年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析 41**

第一节 新日铁化学株式会社 41

一、公司基本概况 41

二、2021-2026年公司经营与销售情况 41

三、2021-2026年公司竞争优势分析 42

第二节 宇部兴产株式会社 43

一、公司基本概况 43

二、2021-2026年公司经营与销售情况 43

三、2021-2026年公司竞争优势分析 44

第三节 台湾律胜科技股份有限公司 44

一、公司基本概况 44

二、公司经营与销售情况分析 45

三、公司竞争优势分析 45

第四节 新揚科技股份有限公司 45

一、公司基本概况 45

二、公司经营与销售分析 46

三、2021-2026年公司竞争优势分析 48

第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司 48

一、公司基本概况 48

二、公司经营与销售情况分析 48

三、2021-2026年公司竞争优势分析 49

四、公司国际化战略发展 49

第六节 旗胜科技股份有限公司 50

一、公司基本概况 50

二、公司经营与销售情况分析 50

三、公司竞争优势分析 51

第七节 东丽世韩有限公司 51

一、公司发展基本概况 51

二、公司经营策略分析 51

第八节 sd电线有限公司 52

**第五章 2021-2026年中国挠性覆铜板产业运营态势分析 53**

第一节 2021-2026年中国覆铜板产业发展总体概述 53

一、中国覆铜板主要产品概述 53

二、中国覆铜板生产发展历程 54

三、中国覆铜板生产发展现状 56

四、中国覆铜板全面调研 57

五、中国覆铜板技改科研成果 58

第二节 2021-2026年中国挠性覆铜板产业发概况 60

一、中国挠性覆铜板产业发概况 60

二、中国挠性覆铜板生产情况分析 61

三、中国挠性覆铜板的产能与产量 63

四、中国挠性覆铜板企业销售状况 64

第三节 2021-2026年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析 64

**第六章 2021-2026年中国挠性覆铜板相关市场调查 66**

第一节 2021-2026年中国挠性印制电路业发展分析 66

一、柔性电路板相关概述 66

二、世界fpc产值及生产企业 69

三、我国fpc生产企业的现状 70

四、fpc多层挠性板的新技术 71

五、重庆彭水建柔性线路板基地 75

第二节 二层型挠性覆铜板在lcd的ic驱动用cof市场现状与发展 75

一、驱动ic用cof 75

二、驱动ic用cof挠性基板的性能特点及市场发展 77

三、cof挠性基板生产现状 77

**第七章 2021-2026年中国印制电路板制造行业经济运行状况 79**

第一节 2021-2026年中国印制电路板制造行业分析 79

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业发展概况 79

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业发展概况 81

第二节 2021-2026年中国印制电路板制造行业总体规模分析 84

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业企业规模分析 84

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业人员规模统计 86

三、2021-2026年中国印制电路板制造行业资产规模分析 87

四、2021-2026年中国印制电路板制造行业负债规模分析 88

五、2021-2026年中国印制电路板制造行业市场规模分析 88

第三节 2021-2026年中国印制电路板制造行业供需平衡分析 89

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业产成品分析 89

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业供给区域分布 90

三、2021-2026年中国印制电路板制造行业销售产值分析 91

四、2021-2026年中国印制电路板制造行业需求区域分布 92

第四节 2021-2026年中国印制电路板制造行业投资状况分析 93

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业投资增长分析 93

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业投资区域分布 96

三、2021-2026年不同规模印制电路板制造企业资产总额分析 97

四、2021-2026年不同性质印制电路板制造企业资产总额分析 98

第五节 2021-2026年中国印制电路板制造行业获利能力分析 99

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业利润总额分析 99

二、2021-2026年不同规模印制电路板制造企业获利能力分析 99

三、2021-2026年不同性质印制电路板制造企业获利能力分析 100

四、2021-2026年中国主要省区印制电路板制造行业获利能力 101

第六节 2021-2026年中国印制电路板制造行业经营效益分析 102

一、2021-2026年印制电路板制造行业偿债能力分析 102

二、2021-2026年印制电路板制造行业盈利能力分析 105

三、2021-2026年印制电路板制造行业毛利率分析 109

四、2021-2026年印制电路板制造行业运营能力分析 111

第七节 2021-2026年中国印制电路板制造行业成本费用分析 115

一、2021-2026年印制电路板制造行业销售成本分析 115

二、2021-2026年印制电路板制造行业销售费用分析 116

三、2021-2026年印制电路板制造行业管理费用分析 117

四、2021-2026年印制电路板制造行业财务费用分析 118

第八节 2021-2026年中国印制电路板制造行业总体结构特征分析 119

一、2021-2026年印制电路板制造行业经济类型结构 119

二、2021-2026年印制电路板制造企业规模结构分析 120

三、2021-2026年印制电路板制造行业区域结构特征 121

第九节 2021-2026年中国印制电路板制造行业集中度分析 124

一、行业资产集中度分析 124

二、行业销售集中度分析 124

三、行业利润集中度分析 125

**第八章 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口数据监测分析 126**

第一节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口数据分析 126

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口数量情况 126

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口金额情况 126

第二节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口数据分析 127

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口数量情况 127

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口金额情况 128

第三节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口均价分析 129

第四节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口国家及地区分析 130

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析 130

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析 131

第五节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口省市分析 132

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口省市情况 132

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口省市情况 133

**第九章 2021-2026年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析 134**

第一节 广东生益科技股份有限公司 134

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第二节 金宝电子(中国)有限公司 138

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第三节 金安国纪科技股份有限公司 140

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第四节 广东超华科技股份有限公司 143

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第五节 山东金宝电子股份有限公司 146

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第六节 无锡宏仁电子材料科技有限公司 149

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第七节 金安国纪科技股份有限公司152

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第八节 胜宏科技(惠州)有限公司155

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第九节 诺德投资股份有限公司157

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第十节 广东嘉元科技股份有限公司160

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

**第十章 2021-2026年中国印刷电路板市场运行分析 171**

第一节 2021-2026年中国印刷电路板行业发展概况 171

一、印刷电路板(pcb)分类及产业链 171

二、中国印刷电路板产量居世界首位 173

三、国内印刷线路板企业区域分布情况 174

四、印刷电路板技术发展水平及趋势 174

五、我国武汉将成为世界最大产业基地 175

六、台湾柔性pcb公司在华东形成产业集群 175

七、重庆打造高技术印刷电路板产业高地 176

第二节 2021-2026年中国印刷电路板市场发展分析 177

一、2021-2026年中国印刷电路板产值规模 177

二、2021-2026年中国印刷电路板产品结构 178

三、中国印刷线路板市场集中度分析 179

四、中国印刷电路板市场需求特点分析 181

第三节 2021-2026年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析 182

一、国内pcb配套产业还需进一步完善 182

二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱 183

三、企业基础技术研究与开发水平薄弱 183

四、行业无序竞争产品定价能力有限 183

五、pcb企业环保投入需进一步加强 184

第四节 2021-2026年中国印刷电路行业发展对策分析 184

**第十一章 中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析 186**

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--pi薄膜 186

一、绝缘基膜的生产方式 186

二、fccl发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求 191

三、世界fccl用pi薄膜在品种和性能上的发展 193

四、世界挠性覆铜板用pi薄膜的市场需求情况 198

第二节 挠性覆铜板用导电材料 199

一、各类铜箔的品种及特征 199

二、压延铜箔 199

三、电解铜箔 199

四、fccl发展对铜箔性能提出更高的要求 201

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂 204

一、fpc用胶粘剂发展概述 204

二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况 205

三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况 208

四、聚xi亚胺粘合剂研究与应用的状况 209

五、世界fpc及fccl用胶粘剂的主要生产厂家及品种 209

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜 210

**第十二章 中国挠性覆铜板用主要应用领域分析**

第一节 航空航天

一、航空航天现状

二、挠性覆铜板在航空航天应用分析

三、挠性覆铜板在航空航天应用趋势

第二节 电脑

一、电脑现状

二、挠性覆铜板在电脑应用分析

三、挠性覆铜板在电脑应用趋势

第三节 汽车

一、汽车现状

二、挠性覆铜板在汽车应用分析

三、挠性覆铜板在汽车应用趋势

第四节 其他

**第十三章 2026-2031年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析 211**

第一节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析 211

一、印刷电路板行业预测分析 211

二、对未来fpc技术发展预测 211

三、fpc发展对fccl提出更高性能的要求 212

第二节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业市场预测分析 215

一、覆铜板生产供给预测分析 215

二、挠性覆铜板供给预测分析 216

三、挠性覆铜板市场调查 216

第三节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测 217

**第十四章 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析 218**

第一节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资环境分析 218

第二节 2026-2031年挠性覆铜板行业投资机会分析 221

一、中国覆铜板行业投资情况分析 221

二、挠性覆铜板区域投资机会分析 221

三、挠性覆铜板行业投资吸引力分析 222

第三节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资风险分析 223

一、宏观经济风险 223

二、市场竞争风险 223

三、原材料市场风险 223

四、技术研发风险分析 224

第四节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业投资策略分析 224

**图表目录**

图表1 挠性聚xi亚胺覆铜板的型号和特性 18

图表2 lpi-301f、lpi-301、lpi-302f、lpi-302 型产品性能要求 21

图表3 lpi-201f、lpi-202f、lpi-203f 型产品性能要求 22

图表4 采用卷状涂布工艺法制3l-fccl的工艺过程图 24

图表5 涂布法二层型fccl的产品构成 25

图表6 涂布法二层型fccl的生产过程示意图 25

图表7 层压法工艺制程 26

图表8 层压生产线 27

图表9 三种2l-fccl的工艺加工特点及剖面结构图 28

图表10 三种2l-fccl制作方式的比较 28

图表12 2021-2026年全球fccl产值增长趋势 31

图表13 2021-2026年美国pcb产值增长趋势 33

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费)　Emai：kf@51baogao.cn

报告编号：122219

本文地址：https://www.51baogao.cn/sc/20190605/122219.shtml

在线订购：点击这里